











## CHEMIKALIEN FÜR ÄTZTECHNISCHE VERFAHREN

Bestell-Nr.	Artikel	Anwendung / Eigenschaften
 B09-0212	Eisen(III)chloridlösung Normal 45 °Bé	Eisen(III)chloridlösung mit einer Dichte von 45 °Bé zum Ätzen der Kupferschicht des Tiefdruckzylinders
B09-0213	W Einbad Eisenchl. FH 48 °Bé	Einbadätzlösung (Dichte 48 °Bé) auf Eisenchloridbasis mit Zusätzen für eine gleichmäßige Ätzung der Kupferschicht des Tiefdruckzylinders
B09-0216	Eisen(III)chloridlösung 45 °Bé mit Flankenschutzmittel	Eisen(III)chloridlösung mit einer Dichte von 45 °Bé und Flankenschutzadditiv zum gleichmäßigen Ätzen
 B09-8002	Kupfer(II)chlorid-Dihydrat	Zum Ätzen von Kupferzylindern nach dem Think-Prozeß
 B03-0541	Laserlack tiefschwarz	Lack für die laserbrenntechnische Herstellung von Tiefdruckzylindern
B03-0590	Laserlack H-B 212	Für Kupfer
B01-0593	Laserlack H-BYC 200	Für Stahl
 B03-0542	Verdünner für Laserlack tiefschwarz	
B01-0191	Verdünner für Laserlack H-B 212 und H-BYC 200	
 A03-0498	Laser-Aktivator	Reinigung und Aktivierung der Kupferoberfläche nach dem Direkt-Lasern
 B09-0175	Säurefeste Kopierschicht HR 100/NS	Set für die kopiertechnische Ätzung in Kupfer mittels eines Negativfilmes; Härtung durch UV-Licht; Schichten sind säurefest; Entfernung nicht gehärteter Stellen mittels Entwickler
B09-0169	Verdünner HR	
B09-0172	Entwickler HR	
 B07-0057	White Shrink Eisen	Walzenbezug für Ätzmaschinen
 C03-0030	Tampon aus Styropor	Mit abgerundeten Kanten